

证券代码：300536

证券简称：*ST 农尚

公告编号：2025-026

武汉农尚环境股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》，现将具体相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度并接受担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内的子公司（包含新增或新设子公司）（以下统称“子公司”）日常生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构申请综合授信额度合计不超过 10 亿元人民币（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、融资租赁等。

在综合授信额度内，公司控股股东及实际控制人将视具体情况为上述授信提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。若公司控股股东及实际控制人为公司及子公司提供无偿担保，则构成关联交易，为此公司董事林峰先生对该项议案回避表决。

二、对外担保额度预计的基本情况

（一）担保情况概述

为满足部分子公司日常生产经营的资金需求，同时，为了加强对公司对外担保的统一管理，增强公司对外担保的计划性与合理性，提升子公司的融资效率，公司计划为部分子公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁等融资业务提供担保。

本次担保额度预计总额不超过 10 亿元人民币，包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内，担保额度可循环滚动使用，但任一时点的担保不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	武汉芯连微电子有限公司	100%	89.29%	0	50,000	95.36%	否
公司	大连芯联微电子有限公司	100%	95.69%	0	10,000	19.07%	否
公司	深圳芯连微科技有限公司	100%	295.15%	0	15,000	28.61%	否
公司	苏州内夏半导体有限责任公司	51%	44.74%	594.35	5,000	9.54%	否
公司	深圳芯联鹏洲科技有限公司	51%	0.03%	0	20,000	38.14%	否
合计		-	-	594.35	100,000	190.72%	-

注：上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、武汉芯连微电子有限公司

公司名称	武汉芯连微电子有限公司
法定代表人	林峰
注册资本	2,000 万元
注册地址	武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（9）室
成立日期	2020-11-04
主营业务	一般项目：软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，云计算装备技术服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件外包服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，信息系统运行维护服务，云计算设备销售，物联网设备销售，互联网设备销售，软件销售，通讯设备销售，电子产品销售，互联网数据服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），知识产权服务（专利代理服务除外），货物进出口，技术进出口，进出口代理，计算机软硬件及辅助设备零售，5G 通信技术服务，通信设备销售，家用电器销

	售, 集成电路芯片及产品销售, 集成电路芯片及产品制造。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 第二类增值电信业务, 第一类增值电信业务, 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司持股 100%
是否为失信被执行人	否

2、大连芯联微电子有限公司

公司名称	大连芯联微电子有限公司
法定代表人	林峰
注册资本	1,000 万元
注册地址	辽宁省大连市中山区同兴街 25 号世界贸易大厦 5 层 521A 号房间
成立日期	2024-02-29
主营业务	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 云计算装备技术服务; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 软件外包服务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础资源与技术平台; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统运行维护服务; 云计算设备销售; 物联网设备销售; 互联网设备销售; 软件销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 互联网数据服务; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 知识产权服务 (专利代理服务除外); 货物进出口; 技术进出口; 计算机软硬件及辅助设备零售; 5G 通信技术服务; 通信设备销售; 家用电器销售; 集成电路芯片及产品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 第二类增值电信业务; 第一类增值电信业务; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司持股 100%
是否为失信被执行人	否

3、深圳芯连微科技有限公司

公司名称	深圳芯连微科技有限公司
法定代表人	林峰
注册资本	200 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A201
成立日期	2024-01-19
主营业务	软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 云计算装备技术服务; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 软件外包服务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础资源与技术平台; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统运行维护服务; 云计算设备销售; 物联网设备销售; 互联网设备销售; 软件销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 互联网数据服务; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 知识产权服务 (专利代理服务除外); 货物进出口; 技术进出口; 计算机硬

	件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；通信设备销售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ² 第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司全资子公司武汉芯连微持股 100%
是否为失信被执行人	否

4、苏州内夏半导体有限责任公司

公司名称	苏州内夏半导体有限责任公司
法定代表人	龚树峰
注册资本	10,000 万元
注册地址	苏州高新区金山东路 78 号 1 幢 Z101 室三层 313
成立日期	2020-01-10
主营业务	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；专业设计服务；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；电子产品销售；显示器件销售；光电子器件销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司全资子公司武汉芯连微持股 51%，韩国 Nexia Device Co., LTD 持股 49%
是否为失信被执行人	否

5、深圳芯联鹏洲科技有限公司

公司名称	深圳芯联鹏洲科技有限公司
法定代表人	林峰
注册资本	500 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 59 号北科大厦 456A
成立日期	2024-09-04
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；云计算设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；5G 通信技术服务；通信设备销售；互联网数据服务；商标代理；物联网技术研发；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ² 互联网信息服务；专利代理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司持股 51%，一云（深圳）算力科技有限公司持股 49%
是否为失信被执行人	否

(二) 被担保人财务状况

单位：万元

被担保人	2024 年 12 月 31 日			2024 年度		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
武汉芯连微电子有限公司	4,753.37	4,244.17	509.19	5,594.83	-201.68	-150.59
大连芯联微电子有限公司	15,903.37	15,218.67	684.70	2,628.80	648.24	484.70
深圳芯连微科技有限公司	13.72	40.50	-26.78	0.00	-26.78	-26.78
苏州内夏半导体有限责任公司	5,404.39	2,418.12	2,986.27	1,113.21	153.72	828.11
深圳芯联鹏洲科技有限公司	197.57	0.05	197.52	0.00	-0.07	-0.07

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，有关担保的方式、期限、金额等主要内容由公司及其子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，具体以最终签署的担保协议为准，但最终实际担保总额将不超过本次审批额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为提高公司决策效率，满足公司及子公司日常生产的资金需要，确保其资金流畅通，加强对公司对外担保的统一管理，增强公司对外担保的计划性与合理性。本次担保额度预计的均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信与担保业务的额度有效期内，根据实际经营需求全权办理授信与担保业务的手续，包括但不限于：商议确定融资金额与利率，签署相关的借款、担保等合同文件。

公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 13 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度有利于公司整体的经营发展，在授信过程中公司控股股东及实际控制人无偿为公司提供担保的行为能够增加公司的融资能力，公司为子公司提供担

保额度预计有利于提升整体融资效率,该事项不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保的事项,并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司已签订对外担保合同总额为 2,300 万元人民币,担保余额为 1,894.35 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 3.61%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的主体单位提供担保,亦不存在涉及诉讼的对外担保情形。

若本次担保预计事项审批通过(按担保金额上限计算),以截至 2025 年 3 月 31 日公司及控股子公司已签订担保合同总额加上本次审议的新增担保总额进行测算,公司及控股子公司对外担保总额为 102,300 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 195.11%。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议;
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日